

加入亨璞，与光同行——上海亨璞半导体 2026 春季校园招聘

一、公司简介

上海亨璞半导体技术有限公司作为国内领先的硅光技术全链条解决方案商，成立于上海张江科学城，已构建起覆盖硅光芯片设计、制造到应用的核心竞争力，是全球少数具备硅光量产经验并实现工艺全流程跑通的企业。公司聚焦高精度光传感与高速光互联领域，掌握硅基 CMOS 工艺、Chiplet 异构集成及光电共封装（CPO）核心技术，在汽车、医疗、能源、数据中心等领域实现商业化突破，其技术壁垒、团队实力与产业协同能力共同构成了在硅光芯片赛道的领先优势。

我们不仅是“硅光芯片领跑者”，更是 OCS、LPO、CPO 等核心技术的突破者与定义者。在这里，每一行代码、每一片晶圆、每一次仿真，都在推动世界走向更快、更智能的连接。赋能 AI 算力，突破电互联性能极限与规模瓶颈，提供芯片设计到量产的全链路解决方案，打造光学 I/O 架构，驱动可持续发展。

二、招聘对象

2026 届应届校招生：2025 年 9 月至 2026 年 8 月期间毕业，博士 2025 年 1 月-2026 年 12 月期间毕业（中国大陆以毕业证为准，非中国大陆地区以教育部学位认证为准）且最高学历毕业后无全职工作经验的同学。

2027 届留用实习：2026 年 9 月-2027 年 8 月期间毕业（中国大陆以毕业证为准，非中国大陆地区以教育部学位认证为准）且实习入职前，尚未取得毕业证书的同学。

三、招聘岗位

部门	岗位名称	专业	学历
固件开发部	嵌入式软件工程师（硅光芯片固件）	软件工程、电子、通信	硕士及以上
芯片设计部	硅光设计工程师	光电子、光学工程	硕士及以上
芯片设计部	高级硅芯片工程师(有源)	光学工程、电子信息、物理学	博士
芯片设计部	硅光芯片工程师	光学工程、电子信息、物理学	硕士及以上
芯片设计部	版图工程师	光电子、光学、电子科学与技术、微电子学、物理学	本科及以上
芯片设计部	硅光测试工程师	光学工程、电子信息、物理学	本科及以上
封装测试部	工艺工程师	通信工程、光纤通信、电子信息、物理、材料、机械	本科及以上
封装测试部	测试工程师	电子、通信、计算机、自动化	本科及以上

系统测试部	系统工程师	通信、电子、自动化、物理学	本科及以上
硬件测试部	硬件工程师	电气、电子工程、通信工程、光电信息	本科及以上

四、工作地点

上海 / 杭州

五、成长与回报

- 有竞争力的薪酬：提供行业领先的薪资待遇，优秀者可享股权激励；
- 多元发展通道：技术深耕与管理双通道，配备导师一对一指导；
- 完善福利保障：六险一金、带薪年假、用餐补贴、节日福利、年度体检；
- 创新氛围：扁平化管理、技术分享会、国内外学术交流机会等。

六、网申通道

PC 端：<https://bpstc.com> → 加入我们 → 校园招聘，选择合适的岗位进行投递；

移动端：扫描以下简历投递二维码



七、招聘流程

网申/内推→简历筛选→职业测评→研发专业面试→综合面试→录用审批→发送录用通知书→签订三方协议

八、联系我们

- 登录亨璞半导体官网进行职位申请或关注微信公众号
- 咨询电话：021-58335358
- 邮件咨询：hr@bpstc.com
- HR 微信：18916502106
- 公司地址：上海市浦东新区丹桂路 799 号 5 幢 7 层